

《半導體》矽品產學合作，秀 3 大主題成果

封測大廠矽品（2325）今（28）日於中興大學舉行產學研究成果發表會，由矽品資深副總簡坤義及中興大學校長薛富盛開場，發表過去 1 年間，矽品與中興、東海、逢甲、交通大學 4 校在封裝技術、產能排程優化、環境友善等三大主題、6 件研究案的精彩成果。

在封裝技術部分，因應電子產品於車用市場蓬勃發展，在高溫、高溼等相對惡劣的環境中能保有穩定效能，矽品透過與中興大學合作研究的導線架與樹脂結合力，對產品的信賴性有了更進一步突破。

針對高階晶圓級封裝製程，矽品藉由與逢甲大學的產學合作，建立準確預估製程中晶圓翹曲的模擬類型，用來設計出產品最佳結構，加速未來產品開發速度，進一步可達到 3C 商品的輕薄短小需求，對醫療、汽車、穿戴式電子產品的效能亦有助益。

除了技術部分提升外，矽品在環境永續的議題也投入許多心力，與逢甲、東海及交大教授的合作交流上，選定噪音、水回收及地震等主題，探討對降低營運風險及外部影響的可行做法，以作為持續改善的依據，朝向企業永續發展的目標邁進。

簡坤義表示，產學合作為創新技術的重要環節之一，將大學豐沛的研發結果轉化為產業科技，生成有價值的產品，才能蓄積台灣企業的創新動能。企業若能在大學進行知識創造過程中有某種程度參與，更能加速日後產品研究開發時程，也能讓參與學生提早與企業接軌。

[\(時報資訊\)](#)